



デバイス開発・故障解析に役立つ SEM観察・分析と試料作製ノウハウ

こんな方におすすめ

- ◎半導体実装（後工程）の基礎知識を学びたい方
- ◎パワー半導体の基礎知識を学びたい方
- ◎デバイス周辺のゴム・プラスチック等劣化解析を行いたい方

受講で身に付くこと

- ◎ パワー半導体のチップ技術やパッケージ技術
- ◎ デバイス周辺材料の分析テクニック

日 程

令和7年8月～12月

会 場

産業科学技術センター

定 員

少人数(実習)
～20名(講義)

受講料

無料～5,000円
(各回により異なります)

カリキュラム（予定）

回	月 日	時 間	内 容	講 師
1	8月22日 (金)	講義4H	パワー半導体の基礎 ～重点ポイント解説版～（座学） パワーエレクトロニクスとパワー半導体、パワー半導体のチップ技術、パワー半導体チップの最新動向、パワー半導体のパッケージ技術、パワー半導体モジュール	大学研究者 メーカー技術者
2	9月10日 (水)	講義4H	デバイス周辺材料の分析技術（座学） デバイス周辺材料の分析で用いる手法についての具体的な分析フロー、方法、事例（主にIR、GC-MS、MALDI TOF-MS、FE-SEM）	メーカー技術者
3	9月26日 (金)	講義6H	半導体実装概論（座学） 先端半導体パッケージの進化、微細接合技術、樹脂封止・絶縁技術、パワー半導体	大学研究者 メーカー技術者
4	10月3日 (金)	講義4H	デバイス評価周辺のゴム・プラスチック劣化解析①（座学） ゴム・プラスチック事後発生防止と対策（その1）：オゾン対策	高分子劣化専門家
5	10月17日 (金)	講義4H	デバイス評価周辺のゴム・プラスチック劣化解析②（座学） ゴム・プラスチック事後発生防止と対策（その2）：アウトガス対策	高分子劣化専門家
6	11～12月 (期間の相談可)	実習3H	デバイス周辺材料の分析技術（実習） デバイス周辺材料の分析で用いる手法についての具体的な分析フロー、方法、事例（主にIR、GC-MS、MALDI TOF-MS、FE-SEM）を実習	産業科学技術センター 職員